

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-057

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司向工商银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》，现将具体内容公告如下：

一、并购贷款基本情况

公司于2019年10月25日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自筹资金12,000万元对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”）进行增资，增资完成后，公司持有浙江天硕59.26%股权，截至目前，公司已支付增资款5,200万元。

根据公司目前的经营状况和资金使用安排，公司于2020年6月23日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过人民币7,115万元的并购贷款，贷款期限为不超过5年，用于支付或置换公司增资浙江天硕的部分款项，并以公司持有的浙江天硕59.26%股权作为质押担保。授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理并购贷款相关手续。

本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次董事会审议的并购贷款额度占用公司2020年度授信额度，在2019年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会表决。

二、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需要，符合公司结构化融资安排，能够更好地支持公司业务活动的开展。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020年6月24日